

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

一、本次募集资金使用计划

公司本次拟公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 57,000.00 万元（含 57,000.00 万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程	62,394.47	30,000.00
2	江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目	19,223.61	10,000.00
3	偿还银行贷款	17,000.00	17,000.00
合计		98,618.08	57,000.00

如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二、本次募集资金投资项目实施的必要性

（一）新增 FPC 产能满足下游市场需求，助力公司实现战略发展

公司是一家专业从事 FPC 研发、设计、制造和销售的高新技术企业，经过多年持续快速的发展，已经成为国内 FPC 行业的代表企业之一。基于 FPC 应用领域及需求的快速发展，以及 FPC 国产化进程加快，公司也持续进行了 FPC 产能扩张，陆续在厦门、江苏、湖北等地投入建设生产基地。随着 5G、车载电子市场的发展，公司已确定以手机模组为基本盘，手机直供、车载电子、工控

医疗、海外业务等重点突破的多元化发展战略，当前公司产能仍将面临较大的缺口。本次募投项目将新增 FPC 和软硬结合板产能，为公司拓展车载电子等新领域、实现战略奠定基础。

（二）迎合软硬结合板发展趋势，满足市场增长和国产替代需求

随着 5G 时代的到来，智能手机等消费电子产品升级换代需求将释放，物联网应用愈发普遍，可穿戴设备、车联网、工业物联等领域应用落地加速，电子信息制造业迎来新一轮发展良机。软硬结合板既有一定挠性，可以实现弯曲，同时具有刚性，具有支撑作用，能满足三维组装需求，节省产品内部空间，已广泛应用于手机摄像头模组、TWS 耳机、汽车倒车雷达影像系统等消费电子、车载电子的产品或零部件中，未来市场广阔。与此同时，软硬结合板由于生产工序繁多、工艺难度高，下游客户当前主要采用台资或外资厂商的产品，国产自给率较低。公司本次建设软硬结合板生产项目，扩大软硬结合板产能，为消费电子、车载电子等领域提供高可靠的软硬结合板产品，满足下游不断增长的市场需求以及国内重点终端客户的国产化替代需求。

（三）优化公司资本结构，降低流动性风险，提高抗风险能力

偿还银行贷款有利于优化资本结构和改善财务状况。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 57.27%，流动负债占负债总额的比例为 88.99%。通过本次募集资金偿还银行贷款可有效降低公司流动负债占比，优化债务结构。未来，随着可转债持有人陆续转股，公司的资产负债率将进一步降低，有利于优化公司的资本结构，从而降低流动性风险，提高公司的抗风险能力，提升公司持续经营能力和盈利水平，促进公司长期发展。

三、本次募集资金投资项目实施的可行性

（一）FPC 行业市场前景广阔，为本次募投项目奠定市场基础

近年来，全球 FPC 产值保持持续稳定增长，FPC 行业市场规模不断扩大。根据 Prismark 数据，2018 年全球 PCB 市场规模为 624 亿美元，其中 FPC 为 127 亿美元，占 PCB 的比重约 20%。同时，Prismark 预计 2022 年 FPC 年产值将超过 149 亿美元，在 PCB 中占比有望提升到 21.62%。受 FPC 产业整体东移影响，

我国成为全球 FPC 发展最快的市场，近年来中国大陆地区 FPC 产值占全球产值的比值不断提升，已从 2005 年的 6.74%大幅增长至 2018 年的 55.8%，预计未来国内市场仍会稳定发展。

随着 5G 的部署和推进，以智能手机、平板电脑等移动电子设备为首的消费类电子产品市场有望继续增长，推动作为其主要连接配件 FPC 的市场发展。同时，汽车智能化使得车载 FPC 的需求增速较快，工控医疗、可穿戴设备、无人机等市场的快速兴起也为 FPC 产品带来新的增长空间。在消费电子产品以及 5G 应用、车载电子等新应用领域持续发展的带动下，未来国内 FPC 行业的市场前景十分广阔，为本次募投项目的实施提供了市场基础。

（二）公司拥有优质的客户资源，可实现 FPC 和软硬结合板的协同发展

电子信息产品市场快速变化、定制化程度高、研发难度大，电子信息产品制造商往往与上游印刷电路板制造商参与共同研发，实现新产品快速市场化，因此下游厂商与上游印制电路板制造商会保持较为稳定的供货关系。公司在 FPC 行业深耕多年，在 FPC 行业占据领先地位，已与众多知名电子产品制造商搭建了稳定的合作关系，通过显示模组、触控模组及指纹识别模组等间接供给华为、小米、OPPO、vivo 等知名品牌手机制造商，并直接供应给 OPPO、联想等客户。公司与全球中小尺寸显示模组厂商天马集团、京东方、群创光电等优质客户的合作分别长达 13 年、12 年和 8 年，合作关系稳定。

同时，公司已布局软硬结合板多年，随着工艺技术的不断成熟，良率的持续提升，公司已与欧菲光、舜宇光学、信利光电、合力泰等国内知名摄像模组厂商建立合作关系。随着本次募投项目的投产，公司软硬结合板供应能力将进一步增强，可依托公司在 FPC 领域积累的优质的客户资源，实现 FPC 业务与软硬结合板业务的协同发展，快速开拓下游应用市场。

（三）公司拥有良好的生产管理经验和工艺技术，保证项目顺利实施

公司自成立以来就主要从事 FPC 的研发、设计、制造和销售业务，经过 10 多年的成长和运营，已经形成了一套完整的管理制度，积累了一批具有丰富管理经验及不同专业技术的核心骨干，掌握了涵盖采购管理、生产制造管理、

品质控制管理、销售管理等方面的管理经验。同时，公司部署了 MES、ERP 等一系列信息化管理系统，从产品选型报价、方案设计、生产工艺设计，到采购、仓储、生产调度和财务等环节实现高度信息化管理。公司多年来积累了丰富的经营管理经验，保障了企业生产经营的有序进行。

公司掌握了 FPC、软硬结合板的核心生产工艺技术，生产过程中不断对加工工艺及设备技术进行改进，在原材料准备、线路制作、阻焊制作、表面涂覆、辅助加工、外形加工、品检包装入库等工序环节积累了丰富的经验。在 FPC 生产制造过程中，“最小线宽/线距”、“导线尺寸精度”以及“孔径尺寸精度”等是衡量企业技术水平的重要指标。经过多年的技术创新改进，公司的 FPC 制程能力已达到国际领先水平，可实现 45μm 级以下超精细线路的大规模量产。与国外技术水平相比，多年来，公司以国外龙头企业为标杆，在不断地创新发展过程中追赶国外先进水平，目前公司大部分性能指标已达到国际领先水平。

四、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程

1、项目概况

项目实施主体为公司控股子公司荆门弘毅电子科技有限公司(以下简称“荆门弘毅”)，项目实施地址为湖北荆门市东宝区 PCB 工业园。项目建成后，预计年产 56 万平方米 FPC 产品。本次募集资金到位后，公司将通过向荆门弘毅借款的方式投入，荆门弘毅根据公司指定的募集资金投资计划具体实施。

2、项目投资概算

项目投资总额为 62,394.47 万元，其中拟使用募集资金投入 30,000.00 万元。

3、经济效益分析

根据测算，本项目完全达产后，可年均可实现销售收入 90,742.36 万元，年均实现净利润 7,632.71 万元。项目内部收益率（所得税前）为 18.89%，投资回收期为 6.49 年。

4、项目所涉及的报批事项的进展情况

本项目已完成备案和环评手续。

（二）江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目

1、项目概况

项目实施主体为公司控股子公司江西弘信柔性电子科技有限公司（以下简称“江西弘信”），项目实施地址为江西省鹰潭高新区白露科技园智联小镇，项目建成后，预计年产 7.2 万平方米软硬结合板产品。本次募集资金到位后，公司将通过向江西弘信借款的方式投入，江西弘信根据公司指定的募集资金投资计划具体实施。

2、项目投资概算

项目投资总额为 19,223.61 万元，其中拟使用募集资金投入 10,000.00 万元。

3、经济效益分析

根据测算，本项目完全达产后，年均可实现销售收入 31,437.69 万元，年均可实现净利润 2,085.25 万元。项目内部收益率（所得税前）为 19.12%，投资回收期为 6.51 年。

4、项目所涉及的报批事项的进展情况

本项目已完成备案和环评手续。

（三）偿还银行贷款

为优化资本结构，提高抗风险能力，降低财务费用，公司本次拟使用 17,000.00 万元募集资金用于偿还银行贷款，以支持公司主营业务发展，提升持续经营能力和盈利水平。

五、本次可转债募集资金运用对公司财务及经营管理的影响

（一）对公司经营状况的影响

本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务进行，是公司在现已掌握的生产工艺基础上通过对生产设备布局、工艺控制等方面进行优化和改进所实施的技改及扩产。项目符合国家相关产业政策及公司战略发展方向，具有良好的

市场发展前景和经济效益。本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司的资金实力将大幅提升，能够满足生产经营的资金需求。项目建成并投产后，将进一步扩大现有产能、扩充公司产品线、丰富产品种类，在公司现有业务基础上提高公司满足市场需求的能力，增强公司的综合竞争力。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模。本次发行完成后，公司的总资产和总负债规模均有所增长。随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，公司负债规模将逐步下降，净资产规模将逐步上升，资产负债率将逐步降低。由于募集资金投资项目经济效益的释放需要一定的时间，本次发行后，若投资者迅速行使转股权利，可能导致公司在短期内存在每股收益和净资产收益率较上年同期下降；但长期来看，随着公司资金实力和经济效益的增强，未来公司营业收入和盈利能力将会得到较大提升，最终为公司和投资者带来较好的投资回报。

六、本次可转债募集资金可行性分析结论

综上所述，本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策及公司整体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的资产质量和盈利水平，增强公司核心竞争力和抗风险能力，促进公司持续、健康发展，募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东利益。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2020年6月19日